

Memorial Técnico

Modelo: 7200-3

Marca: Speedline Technologies

Descrição técnica:

Equipamento para aplicação automática de cola nas placas de circuito impresso. As placas são alimentadas automaticamente pela esteira de transporte na lateral do equipamento, indexadas na esteira, após verificação do posicionamento do produto por meio do sistema de visão. A aplicação é realizada por meio de uma seringa (abastecida de cola, e esse abastecimento é realizado manualmente). A cola é aplicada entre os pads com pressão e velocidade controlada garantindo a posição e quantidade correta. Seu software se comunica com o sistema de rastreabilidade (MES) via telegramas XML, sendo capaz de adquirir a receita dos diferentes produtos do sistema.

Precisão total do sistema: +/- 50 microns

Área de distribuição: 559 mm x 559 mm

Altura transporte: 790 mm a 965 mm

Velocidade Eixo XY: 750 mm/s

Aceleração Eixo XY: 1,5 g

Velocidade Eixo Z: até 220 mm/s

Aceleração Eixo Z: até 3,7 g

Desempenho de posicionamento:

3,00 mm – 45.000 dph

1,27 mm – 50.000 dph

IPC 9850 teste PCB – 35.000 dph

Esteira com ajuste automático de largura

Interface: SHEMA

Aplicação:

Linhas de fabricação de placas eletrônicas de circuito impresso tipo SMT.

Especificações técnicas:

Dimensões: 1270x1440x1529mm

Alimentação elétrica (Volts): 200/ 250 VAC

Frequência (Hz): 50/ 60 Hz

Corrente (Ampere): 9A

Pneumático (Bar): 6 bar

Potência (Watts): 3.600 W

Fotos:

